

公司代码：603005

公司简称：晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晶方科技	603005	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	吉冰沁
电话	0512-67730001	0512-67730001
办公地址	苏州工业园区汀兰巷29号	苏州工业园区汀兰巷29号
电子信箱	info@wlcsp.com	info@wlcsp.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,458,719,428.82	2,307,776,795.90	6.54
归属于上市公司股东的净资产	2,120,269,257.41	1,985,304,226.27	6.80
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额	165,894,692.44	46,736,129.06	254.96
营业收入	454,989,121.00	200,468,502.15	126.96
归属于上市公司股东的净利润	156,057,139.24	21,555,714.83	623.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,069,221.11	676,888.77	18,968.01
加权平均净资产收益率(%)	7.57	1.14	增加6.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.09	444.44
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.09	444.44

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		87,060				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中新创投	国有法人	23.97	77,067,587		质押	24,780,000
EIPAT	境外法人	8.71	28,022,473		无	
大基金	国有法人	8.44	27,133,377		无	
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	未知	4.38	14,100,000		未知	
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	未知	3.13	10,072,202		未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.51	8,056,495		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.23	3,961,020		无	
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.06	3,405,817		未知	
中国银河证券股份有限公司	未知	1.00	3,226,240		未知	

厚睿咨询	境内非 国有法 人	0.70	2,260,278		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

根据 SIA 数据，2020 年第一季度全球半导体市场销售额 1,046 亿美元，同比增长 6.9%。中国集成电路产业 2020 年第一季度保持增长态势，根据中国半导体行业协会统计，2020 年第一季度中国集成电路产业销售额 1,472.7 亿元，同比增长 15.6%，其中：设计业增速最高，主要是国内规模较大设计企业的拉动，设计业同比增长 25.2%，销售额为 574.4 亿元；制造业同比增长 15.1%，销售额为 451.4 亿元；封测业同比增长 5.7%，销售额为 446.9 亿元。全年来看，根据世界半导体贸易统计（WSTS）2020 年 6 月的预测，由于新冠病毒疫情对全球经济和供应链的影响，2020 年半导体行业的营收相比 2019 年仅有微小增幅。

公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦于传感器领域，封装的产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等，相关产品广泛应用在智能手机、安防数码、身份识别、汽车电子、3D 传感等市场领域。2020 年上半年，随着手机三摄、四摄等多摄像头趋势持续渗透普及，不同摄像头的功能呈现差异化定位，使得景深、微距等低像素摄像头广泛应用，手机摄像头市场需求呈现爆发式增长，同时安防数码摄像头保持稳步增长，汽车电子摄像头开始导入量产，使得公司封装订单饱满。为满足客户增长的订单需求，公司一方面持续进行产能的规划布局，提升生产规模，同时加强技术的创新与工艺优化，不断提升工艺能力、管理与运营效率。基于此，公司的营收与利润规模呈现快速增长态势。

2020 年 1-6 月，公司实现销售收入 45,498.91 万元，同比增长 126.96%，实现净利润 15,605.71 万元，同比增长 623.97%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,906.92，同比增长 18,968.01%。从季度情况来看，公司 2020 年二季度相比一季度也呈现持续增长的态势，二季度实现销售收入 26,432.51 万元，环比一季度增长 38.63%，实现净利润 9,394.37 万元，环比一季度增长 51.25%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,657.98 万元，环比一季度增长 45.90%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用